

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第4区分

【発行日】平成24年2月9日(2012.2.9)

【公表番号】特表2011-517302(P2011-517302A)

【公表日】平成23年6月2日(2011.6.2)

【年通号数】公開・登録公報2011-022

【出願番号】特願2010-544582(P2010-544582)

【国際特許分類】

B 3 2 B	9/00	(2006.01)
H 0 5 B	33/04	(2006.01)
G 0 9 F	9/30	(2006.01)
H 0 1 L	27/32	(2006.01)
H 0 1 L	51/50	(2006.01)

【F I】

B 3 2 B	9/00	A
H 0 5 B	33/04	
G 0 9 F	9/30	3 0 9
G 0 9 F	9/30	3 6 5 Z
H 0 5 B	33/14	A

【手続補正書】

【提出日】平成23年12月14日(2011.12.14)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

装置であつて、

- ・構成部材(1)と、
- ・当該構成部材(1)を湿気および/または酸素に対してカプセル封入するためのカプセル封入ユニット(2)を有しており、
- ・当該カプセル封入ユニット(2)は、第1の層(21)と、当該第1の層の上の第2の層(22)を、前記構成部材(1)の少なくとも1つの表面(19)上に有しており、
- ・前記第1の層(21)および前記第2の層(22)はそれぞれ無機材料を有しており、
- ・前記第1の層(21)は直接的に前記構成部材(1)上に配置されており、
- ・前記第2の層(22)は直接的に前記第1の層(21)上に配置されており、

前記第2の層上に保護層が被着されており、当該保護層はプラスチックを有している、  
および/または、前記構成部材(1)はカバー部(17)をガラスフィルムまたはガラス  
プレートの形状で基板(10)上に有しており、前記カプセル封入ユニット(2)は当該  
カバー(17)と前記基板(10)との間に配置されている、ことを特徴とする装置。

【請求項2】

装置であつて、

- ・構成部材(1)と、
- ・当該構成部材(1)を湿気および/または酸素に対してカプセル封入するためのカプセル封入ユニット(2)を有しており、
- ・当該カプセル封入ユニット(2)は、第1の層(21)と、当該第1の層の上の第2

の層(22)を、第3の層(23)上に、前記構成部材(1)の少なくとも1つの表面(19)上有してあり、

- ・前記第3の層(23)は直接的に前記構成部材(1)上に配置されており、
- ・前記第1の層(21)は直接的に前記第3の層(23)上に配置されており、
- ・前記第2の層(22)は直接的に前記第1の層(21)の上に配置されており、
- ・前記第1の層(21)および前記第2の層(22)はそれぞれ無機材料を有してあり、
- ・前記第3の層(23)は、無定形態の無機材料を有してあり、

前記第2の層上に保護層が被着されており、当該保護層はプラスチックを有している、  
および/または、前記構成部材(1)はカバー部(17)をガラスフィルムまたはガラス  
プレートの形状で基板(10)上有してあり、前記カプセル封入ユニット(2)は当該  
カバー(17)と前記基板(10)との間に配置されている、

ことを特徴とする装置。

#### 【請求項3】

- ・前記第2の層(22)および前記第3の層(23)は同様に構成されている、請求項1または2記載の装置。

#### 【請求項4】

装置であって、

- ・構成部材(1)と、
- ・当該構成部材(1)を湿気および/または酸素に対してカプセル封入するためのカプセル封入ユニット(2)を有しており、
- ・当該カプセル封入ユニット(2)は、第1の層(21)と、当該第1の層の上の第2の層(22)を、前記構成部材(1)の少なくとも1つの表面(19)上有してあり、
- ・前記第2の層(22)は直接的に前記第1の層(21)上に配置されおり、
- ・前記第1の層(21)および前記第2の層(22)はそれぞれ無機材料を有してあり、
- ・前記カプセル封入ユニット(2)は60以上の中でも、かつ85%以上の相対的大気湿度の中でも、500時間以上、気密性であり、

前記第2の層上に保護層が被着されており、当該保護層はプラスチックを有している、  
および/または、前記構成部材(1)はカバー部(17)をガラスフィルムまたはガラス  
プレートの形状で基板(10)上有してあり、前記カプセル封入ユニット(2)は当該  
カバー(17)と前記基板(10)との間に配置されている、

ことを特徴とする装置。

#### 【請求項5】

- ・前記第1の層(21)および前記第2の層(22)はそれぞれ体積体構造を有しており、
- ・前記第2の層(21)の体積体構造は、前記第1の層(22)の体積体構造に依存しない、請求項1から4までのいずれか1項記載の装置。

#### 【請求項6】

- ・前記第2の層(22)の体積体構造は、前記第1の層(21)の体積体構造よりも高い非晶質性を有している、請求項5記載の装置。

#### 【請求項7】

- ・前記第2の層は無定形態である、請求項1から6までのいずれか1項記載の装置。

#### 【請求項8】

- ・前記第2の層(22)は変化する厚さ(9)を有しており、当該厚さは前記第1の層(21)の表面構造および/または体積体構造に依存しない、請求項1から7までのいずれか1項記載の装置。

#### 【請求項9】

- ・前記厚さ変化は10%以下である、請求項8記載の装置。

#### 【請求項10】

・前記カプセル封入ユニット(2)は多数の第1の層(21、21')と、多数の第2の層(22、22')を有しており、

・前記第1の層および第2の層(21、21'、22、22')は、交互に相互に重なって被着されている、請求項1から9までのいずれか1項記載の装置。

#### 【請求項11】

・前記カプセル封入ユニット(2)は前記構成部材(1)を完全に包囲する、請求項1から10までのいずれか1項記載の装置。

#### 【請求項12】

・前記装置は、多数のカプセル封入ユニット(2、2')を有しており、当該カプセル封入ユニットは前記構成部材(1)の種々異なる表面上に配置されている、請求項1から11までのいずれか1項記載の装置。

#### 【請求項13】

・前記構成部材(1)は基板(10)を含んでおり、  
・前記カプセル封入ユニット(2)は直接的に前記基板(10)上に被着されている、請求項1から12までのいずれか1項記載の装置。

#### 【請求項14】

・前記構成部材(1)はカバー部(17)を基板(10)上に有しており、  
・前記カプセル封入ユニット(2)は、当該カバー部(17)と前記基板(10)との間に配置されている、請求項1から12までのいずれか1項記載の装置。

#### 【請求項15】

・前記カバー部(17)と前記基板(10)との間に接続材料(16)が配置されており、  
・前記カプセル封入ユニット(2)は、前記基板(10)と当該接続材料(16)との間、および／または前記カバー部(17)と当該接続材料(16)との間の境界面(109、179)をカプセル封入する、請求項1から14までのいずれか1項記載の装置。